

平成 25 年 5 月 1 日
電気化学工業株式会社

平成 24 年度高分子学会賞（技術部門）受賞について 「エレクトロニクスプロセス用次世代型仮固定剤の開発」 ～ テンプロック®（TEMPLOC）による技術革新 ～

電気化学工業株式会社（社長：吉高紳介、以下「デンカ」）は、「エレクトロニクスプロセス用次世代型仮固定剤の開発」について、公益社団法人高分子学会の「平成 24 年度高分子学会賞（技術部門）」を受賞いたしましたのでお知らせいたします。第 62 回高分子学会年次大会において授賞式が行われる予定です（5 月 30 日京都国際会館）。

公益社団法人高分子学会は、日本の高分子科学・技術の進歩をはかるため、独創的かつ優れた業績を挙げた研究・技術に対して「高分子学会賞」を贈り表彰しています。

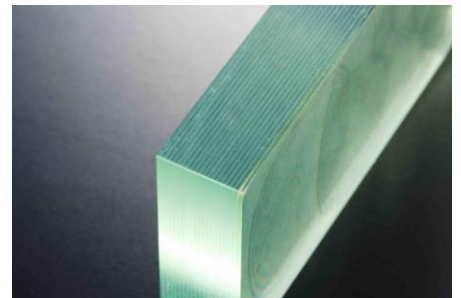
今回の受賞は、デンカが開発した仮固定剤「**テンプロック®（TEMPLOC）**」および「**テンプロック®**」を用いたスマートフォン用強化ガラス「**積層切断加工工法**」の独創的な研究開発に対して、エレクトロニクスプロセスの技術革新と環境負荷低減への将来性をご評価いただいたものです。

1. デンカの仮固定剤「**テンプロック®**」の開発について

デンカは、約半世紀にわたり工業用接着剤の開発・販売を行い、これまで「いかに強固に接着するか」ということに注力してきました。近年の電子材料素材の高機能化に伴う材料の「保護」や「剥離」へのニーズの高まりに着目し、2005 年よりまったく新しいコンセプトの仮固定剤開発に着手しました。

この開発に当たっては、「接着と剥離」という二律背反する性能のバランスを保たせるため、従来の接着剤組成や硬化メカニズムを根本から見直しました。素早い反応硬化、切断加工時の耐薬品性・耐熱性向上による強度保持、更に温水等の浸漬により仮固定剤がフィルム状に簡単に剥離し、加工する部材を保護する材料設計を行いました。

その結果、加工後の剥離の際、従来のワックス系仮固定剤が必要としていた有機溶剤を不要となるなど、工程の省力化だけでなく、作業環境の改善、洗浄廃液処理による環境負荷の大幅な低減を可能とする、画期的な仮固定剤「**テンプロック®**」の開発に至りました。



2. 「**テンプロック®**」の用途展開について

「**テンプロック®**」の用途として今注目されているのが、スマートフォン用強化ガラスの加工です。これまで機械的切断が困難であった「センサーガラス」加工への「**テンプロック積層工法**」の普及が急速に進んでいます。ガラスを積層して強固に接着することによって、「センサーガラス」表面の保護やチッピングによるガラス自体の強度低下を防ぎ、生産性と収率の大幅な向上を実現しました。デンカは引き続き、更なる用途展開に努めてまいります。



3. 「DENKA100」目標達成のためのソリューションビジネスの強化

デンカは仮固定剤の素材開発・販売だけでなく、技術指導や加工品の販売などガラス加工全体をサポートするソリューションビジネスを展開しています。経営計画「DENKA100」目標達成のため、市場に密着した事業を展開し課題の解決に努めるとともに、環境負荷低減を実現する製品を提供して社会へ貢献してまいります。

以上

本件及び製品の問合せ先：デンカアドテックス株式会社 電話：03-5290-5620 ウェブサイト：www.d-adtecs.co.jp

※ デンカはテンプロック事業を、子会社であるデンカアドテックス株式会社へ集約し、仮固定剤からガラス加工装置、加工製品などの関連サービスをワンストップで提供する、ソリューション体制を構築しております。